

中国材料研究学会

第 339 场中国工程科技论坛—中国新材料产业高峰论坛

第三届中国新材料产业发展大会

暨 2021 “科创中国”新材料专家、技术、需求推介会

会议通知（第三轮）

面向国家“十四五”新材料“自立自强”的新发展战略，紧紧围绕“前瞻布局”、“短板突破”和“自我保障”的国家重大需求，从基础研究、产业发展、技术应用三个维度研讨关键战略新材料的发展问题，助力支撑我国高新技术、高端制造和重大工程迈向世界一流的发展水平。

本届大会直接服务于中国工程院《新材料前沿技术与科普发展战略研究》、《新材料创新能力提升战略研究》、《化工、冶金与先进材料工程科技未来 20 年发展战略研究》和中国科协《“科创中国”新材料科技服务团专项》等战略咨询项目的实施。

大会主要内容包括：4 个大会报告；37 个新材料领域产业论坛；首届中国新材料高层战略专家会议（“材料强国”论坛）；“科创中国”近千位新材料领域专家征集与推介；“科创中国”近千项新材料领域优秀成果征集与推介；“科创中国”近千项新材料技术需求征集、发布与对接；《中国新材料研究前沿报告 2021》研讨会；《中国新材料产业发展报告 2021》研讨会以及《中国新材料技术应用报告 2021》研讨会等。

会议时间：2021 年 10 月 21~24 日

会议地点：湖北省武汉市中国光谷科技会展中心

主办单位：中国工程院

中国科学技术协会

共同主办：中国材料研究学会

支持单位：国家发展改革委员会

工业和信息化部

科学技术部
中国科学院
国家自然科学基金委员会

承办单位：中国材料研究学会
中国工程院化工、冶金与材料工程学部
华中科技大学

共同承办：武汉市科学技术局

大会名誉主席：周廉、黄伯云、干勇

大会主席：李元元、魏炳波

分论坛设置（时间：2021年10月22日下午、23日）

F01: 生物医用材料

主 席：顾忠伟、王欣宇、刘宣勇、潘浩波
联系人：何一燕 15651795251 yiyanche@njtech.edu.cn
晏乐三 15972199746 lsyan@whut.edu.cn

F02: 石墨烯材料及应用

主 席：李义春、冯冠平、常海欣
联系人：胡振鹏 13061368540 zhenpenghu0530@163.com

F03: 锂电材料

主 席：吴锋、黄学杰、陈人杰
联系人：陈人杰 13671350662 chenrj@bit.edu.cn

F04: 镁及镁合金

主 席：潘复生、丁文江、蒋斌、曾小勤
联系人：张昂 18811328068 angzhang@cqu.edu.cn

F05: 环境工程材料

主 席：聂祚仁、许开华、吴少鹏、李建荣、崔素萍
联系人：陈文娟 13401197245 chenwenjuan@bjut.edu.cn

F06: 绿色建材

主 席：姚燕、胡曙光、马振珠、王发洲、余其俊、程新、沈晓冬、文寨军
联系人：吴浩 13581583188 whqxq@163.com
刘晶 15210304268 liujing@cbmamil.com.cn

F07: 信息电子材料

主 席：陈弘达、徐科、张旭、缪向水
联系人：程传同 15810366892 chengchuantong@semi.ac.cn

F08:液态金属前沿材料

主 席：刘静、邓中山、杨应宝、于洋、袁晓龙
联系人：崔云涛 13581543821 cuiyuntao@mail.ipc.ac.cn

F09:增材制造材料研发、产业化与应用

主 席：史玉升、卢兴、闫春泽
联系人：吴甲民 18696154615 jiaminwu@hust.edu.cn
蔡超 15072366590 chaocai@hust.edu.cn

F10:光催化材料

主 席：邹志刚、李朝升
联系人：李朝升 13770645436 zsli@nju.edu.cn

F11:功能纤维材料

主 席：朱美芳、端小平、王玉萍
联系人：廖耀祖 13127718931 yzliao@dhu.edu.cn
陈丽芸 13564639091 06family@dhu.edu.cn

F12:气凝胶材料

主 席：沈晓冬、张忠伦、韩继先
联系人：刘振森 18596321066 liuzhensen1223@163.com
王明铭 18810960215 wmm80s@126.com

F13:电子元器件关键材料与技术

主 席：周济、周益春、杨组培
联系人：石锋 18853227408 sf751106@163.com

F14:氢能应用关键材料与技术

主 席：周少雄、邹志刚、张永明、齐志刚、李箭
联系人：武英 13671180465 Yingwu2000@hotmail.com

F15:非晶材料

主 席：汪卫华、姚可夫、惠希东、李扬德
联系人：邵洋 15901313826 shaoyang@tsinghua.edu.cn

F16:化学催化材料

主 席：徐春明、刘坚
联系人：张瑛 13718981328 y.zhang@cup.edu.cn

宋卫余 18801012455 songwy@cup.edu.cn
孙源卿 13610728681 yqsun@cup.edu.cn

F17:钛合金

主 席：赵永庆、王俭、刘向宏、唐进
联系人：贾尉菊 13484674005 Diana_1025@126.com

F18:碳点功能材料

主 席：杨柏、康振辉
联系人：张恺 13180807827 zk@jlu.edu.cn

F19:高性能铝合金材料及应用

主 席：熊柏青、范云强、张新全
联系人：闫宏伟 18614088273 yanhongwei@grinm.com

F20:耐蚀材料与腐蚀控制

主 席：毛新平、韩恩厚
联系人：张志明 15040321308 zmzhang@imr.ac.cn

F21:膜材料

主 席：范益群、邢卫红、金焱
联系人：陈献富 15996473703 chenxianfu@njtech.edu.cn

F22:铜基新材料

主 席：谢建新、杨斌
联系人：汪航 13766359267 wanghang@jxust.edu.cn
汪志刚 15179089066 zgwang2013@jxust.edu.cn

F23:先进无机材料

主 席：宋力昕、黄政仁、傅正义、黄云辉、陈宇红、吴贲华、厉宝平、吴成铁
联系人：张明辉 13651820751 zhangminghui@mail.sic.ac.cn
王雪珍 13989368957 wangxzh@nimte.ac.cn
许恒辉 18971022032 xuhh@hust.edu.cn
海万秀 18195085564 wxhai@nun.edu.cn
顾中华 15921044832 guhua@mail.sic.ac.cn
毛朝梁 18918114486 maochaoliang@mail.sic.ac.cn
张帆 13986082496 zhfan@whut.edu.cn

F24:高性能碳纤维及其复合材料

主 席：鄧晓
联系人：安晓鹏 18101270824 Anxiaopeng@cbma.com.cn

F25:海洋工程材料及工艺

主 席：朱英富、王其红、范润华

联系人：孟祥军 13603791367 Mxj725@163.com
孙凯 13162623522 kais@shmtu.edu.cn

F26:水处理功能材料

主 席：王崇臣、刘艳彪、郎贤军

联系人：赵晨 13811952431 zhaochen1@bucea.edu.cn

F27:难熔金属

主 席：王金淑、吴玉程

联系人：胡鹏 18613865598 pengh@bjut.edu.cn

F28:表面工程

主 席：刘敏、吴勇、李长久、郭洪波、王立平、刘宣勇、邓畅光

联系人：闫星辰 15812468930 yanxingchen@gdinm.com

F29:高性能复合材料

主 席：李贺军、张联盟、董绍明

联系人：罗瀚 15671554482
石敏先 18971425643
张雨雷 13991291452 zhangyulei@nwpu.edu.cn

F30:化工新材料

主 席：钱锋、庄毅、解孝林

联系人：赵玲 13816451511 zhaoling@ecust.edu.cn

F31:纳米材料与器件

主 席：何军、刘威

联系人：刘威 17802713301 wliu@whu.edu.cn

F32:功能水性涂层新材料

主 席：谭必恩、武利民、徐祖顺、瞿金清

联系人：王笑颜 18612938524 xiaoyan_wang@hust.edu.cn

F33:2021 5G 手机新材料发展趋势论坛

主 席：丁文江、王长振

联系人：鲁林宏 13541008849 lu.linhong@xincailiao.com

F34:先进电工材料

主 席：程时杰、蒋凯

联系人：李浩秒 18971431077 lih@hust.edu.cn
周敏 13971684413 minzhou0729@hust.edu.cn

F35:材料产业高质量发展论坛

主 席：王海舟

联系人：胡少成 13681482023 hushaocheng@ncschina.com

F36:有机光电功能材料与器件

主 席：朱道本、张德清

联系人：狄重安 13810097188 dich@iccas.ac.cn
李诚 13811004486 licheng1987@iccas.ac.cn
王成亮 15907129589 clwang@hust.edu.cn

FA: 全国高校材料院长论坛

主 席：周华民、卢兴、张锦、林元华

联系人：周何乐子 13437165632 hulezizhou@hust.edu.cn
谢云鹏 15002720927 xieyp@hust.edu.cn

注册费标准及付款方式

1、2021年10月20日（含20日）交费	2、2021年10月21-23日现场交费
普通代表：1700元	普通代表：2000元
会员代表：1500元	会员代表：1800元
学生代表：800元	学生代表：1000元

注：由于网银汇款不是实时到账，10月10日后请尽量选择在线支付，以免影响您的正常权益。

在会员有效期内的中国材料研究学会个人会员可以选择会员代表类型。相关会员信息可登录中国材料研究学会会员网站查询，<https://cmrs.scimall.org.cn/member/login.php>

温馨提示：凡是参加本次大会的代表，将自动成为中国材料研究学会个人会员，如您不同意入会，请与中国材料研究学会秘书处联系。

付款方式 1：在线支付

请参会代表登录网站，注册后进行在线支付。

在线支付方式可实时更新参会状态，请尽量选择在线支付，以便及时准确的查询参会代表信息。

付款方式 2：网银汇款

开户名称：中国材料研究学会

开户银行：中国工商银行紫竹桥支行（北京市海淀区）

银行帐号：0200 2355 1920 1069 811

欢迎从事新材料产、学、研、用领域的专家、学者、科技工作者、青年学生、政府有关的管理部和领导、企业家及其它相关人员参会。

有关参会注册、摘要投稿等会议详情，详见会议网站 <https://camidc2021.scimeeting.cn>。

酒店预订

预订酒店请直接拨打酒店订房电话，说明是参加第三届中国新材料产业发展大会即可。具体酒店信息，请登录大会官网查看。

网址：https://camidc2021.scimeeting.cn/cn/web/index/12163_954496__

大会各项工作联系人

大会秘书长：张增志 电话：13701257391

大会总协调：刘 枫 电话：13801137582

卢 兴 电话：13517224573

会议注册咨询：张永政 电话：010-68726306、15911025119

邮箱：camidc@163.com

财务咨询：王宇翔 电话：13141248851

邮箱：wang133211@163.com

赞助咨询：王文亮 电话：15611013638

个人会员咨询：张永政 电话：010-68726306、15911025119

邮箱：chinese_mrs_vip@163.com

“科创中国”三个一千发布：赵国栋 电话：15148569393

开幕式、“学会三十周年”：马晓梅 电话：13810257570

分论坛会议室保障：刘阳 电话：13001199153

酒店预订咨询：韩超男 电话：13210217521

安防防疫：张艺群 电话：18865925777

大会餐饮：王清梅 电话：18765211092

